

证券代码：688798
转债代码：118065

证券简称：艾为电子
转债简称：艾为转债

公告编号：2026-057

上海艾为电子技术股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2021年首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）4,180万股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币320,104.40万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币16,578.26万元后，实际募集资金净额为人民币303,526.14万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币15,005.88万元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币305,098.52万元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为190,132.00万元可转换公司债券，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券19,013,200张，每张面值100元，募集资金总额为人民币190,132.00万元，扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元（不含税）后，已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）于2026年1月28日汇入公司募集资金监管账户，实际到账金额为188,901.08万元。另扣除其他发行费用 274.30万元（不含税）后，实际募集资金净额为188,626.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2026]第 ZA10054 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金274,278.78万元，其中以前年度累计使用募集资金237,888.44万元，本半年度使用募集资金36,390.34万元。截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股份的募集资金账户余额为4,158.94万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 8 月 10 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	320,104.40

其中：超募资金金额	56,712.42
减：直接支付发行费用	16,578.26
二、募集资金净额	303,526.14
减：	
以前年度已使用金额	237,888.44
本半年度使用金额	36,390.34
暂时补流金额	29,748.99
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	4.90
项目结项结余资金利息补充流动资金	7,613.43
加：	
募集资金利息收入	12,278.90
三、报告期期末募集资金余额	4,158.94

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 9,104.48 万元，其中本半年度使用募集资金 9,104.48 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金账户余额为 18,850.17 万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026 年 1 月 28 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	190,132.00
其中：超募资金金额	0.00
减：需直接支付发行费用	1,505.22
二、募集资金净额	188,626.78
减：	
本半年度使用金额	9,104.48
现金管理金额	161,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
加：	
募集资金利息收入	576.13
尚未支付的发行费用	51.89
三、报告期期末募集资金余额	18,850.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》，并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年1月16日再次更新了《管理制度》，并于2024年2月5日经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年7月29日再次更新了《管理制度》，并于2025年8月14日经本公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2026年4月10日再次更新了《管理制度》，并于2026年4月30日经本公司2025年年度股东会审议通过。

公司对2021年首次公开发行股份募集资金设立募集资金专户，公司及保荐人中信证券股份有限公司于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年1月23日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2025年9月18日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人

的公告》（公告编号：2025-047），公司因聘请中信建投证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐人中信建投证券与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司市南分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，公司及保荐人中信建投证券于2026年1月29日与招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海龙柏支行、中国银行上海市吴中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行闵行支行、浙商银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行上海莘庄支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2026年4月23日与招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

1. 2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日，公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”和“发

展与科技储备资金”已结项并注销对应的募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 8 月 10 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121928744310666	97.80	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013001344792	-	已注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501352188	-	已注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	439081861450	-	已注销
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行闵行支行	03004644696	3,996.19	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03004644378	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012101685873	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005501767	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	中国银行上海市吴中路支行	446885714103	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939323310118	64.92	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	上海银行闵行支行	03005824825	0.00	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824795	0.00	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824817	0.00	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824787	0.00	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121941213410012	0.00	使用中
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939330310013	0.00	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121944966010017	0.00	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121945865310018	0.00	使用中

路技术有限公司	司上海分行营业部			
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121953529210020	0.00	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	411910565110021	0.00	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121980045910022	0.00	使用中
合计			4,158.94	

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026 年 1 月 28 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121928744310006	460.09	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013302034822	2,243.66	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闸北支行	86010202601229809	14,565.65	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	216440100100221626	39.54	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	458540801996	0.17	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800006449	471.19	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03006572714	0.46	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行营业部	2900000010120101150977	182.54	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000009206	796.39	使用中
上海艾为电子技术股	交通银行上海莘庄支行	310066263011991082858	90.47	使用中

份有限公司				
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121939330310033	0.00	使用中
芯界微(上海)科技有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121990024710050	0.00	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121941213410032	0.00	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121939323310034	0.00	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	510905487810035	0.00	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121941167210036	0.00	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121944966010037	0.00	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121945865310038	0.00	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	128915146410039	0.00	使用中
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121953529210040	-	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	411910565110041	-	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行营业部	121980045910042	0.00	使用中
合计			18,850.17	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2021年首次公开发行股份

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基

于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材料、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

2026年半年度公司2021年首次公开发行股份使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为20,308.69万元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,644.91万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，222.41万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月8日出具了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10886号）。截至2026年6月30日止，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金2,644.91万元和已支付发行费用222.41万元的置换。

2026年半年度公司向不特定对象发行可转换公司债券使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为1,498.97万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2021年首次公开发行股份

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产

经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2026年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为29,748.99万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 8 月 10 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
39,653.99	2025 年 8 月 12 日	12 个月	2025 年 8 月 12 日	2025 年 9 月 29 日	400
				2026 年 3 月 30 日	600
				2026 年 4 月 24 日	1,700
				2026 年 5 月 14 日	5
				2026 年 5 月 29 日	4,800
				2026 年 6 月 15 日	800
				2026 年 6 月 29 日	1,600

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2021年首次公开发行股份

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不

变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2026年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为0元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 8 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
90,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2025 年 8 月 12 日	2026 年 8 月 11 日	2025 年 8 月 12 日

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

本公司于2026年2月11日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18亿元（含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，产品投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2026年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为161,300万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026 年 1 月 28 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
180,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2026 年 2 月 12 日	2027 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 12 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2026 年 1 月 28 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海艾为电子技术股份有限公司	浦发银行	结构性存款	存款	14,000	2026/2/12	2026/8/12	2026/8/12	14,000	1.85%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行	结构性存款	存款	2,450	2026/3/2	2027/1/25	2027/1/25	2,450	1.72%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行	结构性存款	存款	2,550	2026/3/3	2027/1/27	2027/1/27	2,550	1.72%	/
上海艾为电子	建设银行	结构性存款	存款	5,000	2026/3/2	2026/9/25	2026/9/25	5,000	2.00%	/

技术股份有限公司										
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行	结构性存款	存款	40,000	2026/3/2	2026/8/28	2026/8/28	40,000	2.01%	/
上海艾为电子技术有限公司	交通银行	结构性存款	存款	10,800	2026/3/2	2027/1/25	2027/1/25	10,800	1.92%	/
上海艾为电子技术有限公司	上海银行	结构性存款	存款	15,000	2026/4/2	2026/9/30	2026/9/30	15,000	1.85%	/
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行	结构性存款	存款	21,000	2026/5/6	2026/7/16	2026/7/16	21,000	2.00%	/
上海艾为电子技术有限公司	招商银行	结构性存款	存款	32,000	2026/5/18	2026/8/17	2026/8/17	32,000	1.55%	/
上海艾为电子技术有限公司	浙商银行	结构性存款	存款	7,100	2026/6/12	2026/7/13	2026/7/13	7,100	1.80%	/
上海艾为电子技术有限公司	宁波银行	结构性存款	存款	5,000	2026/6/24	2026/9/24	2026/9/24	5,000	2.00%	/
上海艾为电子技术有限公司	浦发银行	结构性存款	存款	3,500	2026/6/26	2026/7/28	2026/7/28	3,500	1.75%	/
上海艾	建设银	结构性	存款	2,900	2026/6/	2026/7/	2026/7/	2,900	2.00%	/

为电子 技术股 份有限 公司	行	存款			29	28	28			
-------------------------	---	----	--	--	----	----	----	--	--	--

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

1. 2021年首次公开发行股份

本公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”已完成，同意公司将“电子工程测试中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金7,577.74万元永久补充流动资金。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

本公司于2026年6月27日披露了《关于部分募投项目结项及注销部分募集资金专户的公告》，公司募投项目“发展与科技储备资金”已结项，节余募集资金利息1.06万元（利息扣减手续费等）已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金，并注销了相应的募集资金专户；公司于2025年8月已结项的募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项已支付完毕，公司已将节余募集资金利息36.29万元（利息扣减手续费等）全部转入募投项目“高性能模拟芯片研发和产业化项目”，并注销了相应的募集资金专户。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年4月8日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》。综合考虑向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的实施情况，提高募集资金使用效率，同意新增公司艾为电子、公司全资子公司上海艾为半导体技术有限公司及其全资子公司芯界微（上海）科技有限公司作为募投项目“全球研发中心建设项目”的实施主体，新增上海艾为半导体技术有限公司、芯界微（上海）科技有限公司、公司全资子公司上

海艾为集成电路技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、合肥艾为集成电路技术有限公司、成都艾为微电子科技有限公司、哈尔滨艾为微电子技术有限公司、大连艾为微电子技术有限公司、北京艾为微电子技术有限公司作为募投项目“端侧 AI 及配套芯片研发及产业化项目”、“车载芯片研发及产业化项目”及“运动控制芯片研发及产业化项目”的实施主体。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2021 年 8 月 10 日											
本年度投入募集资金总额			36,390.34											
已累计投入募集资金总额			274,278.78											
变更用途的募集资金总额			40,280.57											
变更用途的募集资金总额比例			13.27%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
智能音频芯片研发和产业化项目	研发项目	否	44,164.59	40,833.88	40,833.88	24.39	42,857.37	2,023.49	104.96	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
5G 射频器件研发和产业化项目	研发项目	否	21,177.05	15,519.91	15,519.91	6.88	16,741.67	1,221.76	107.87	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
马达驱动芯片研发和产业化项目	研发项目	否	36,789.12	25,701.40	25,701.40	4.72	27,869.39	2,167.99	108.44	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	生产建设	是	40,824.76	20,619.76	20,619.76	-	21,892.29	1,272.53	106.17	2023 年 10 月	不适用	不适用	否	

电子工程测试中心建设项目	生产建设	是	73,858.20	94,063.20	94,063.20	15,151.40	85,911.55	-8,151.65	91.33	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	研发项目	是	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,235.55	30,335.39	335.39	101.12	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
超募资金	回购股份	不适用	56,712.42	10,004.40	10,004.40	-	10,004.40	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发项目	是	-	66,783.59	66,783.59	13,967.40	38,666.72	-28,116.87	57.90	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			303,526.14	303,526.14	303,526.14	36,390.34	274,278.78	-29,247.36					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不存在										
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司不存在项目可行性发生重大变化的情形										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见说明三（二）										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见说明三（三）										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见说明三（四）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不存在										
募集资金结余的金额及形成原因			详见说明三（六）										
募集资金其他使用情况			详见说明三（七）										

注 1：智能音频芯片研发和产业化项目、5G 射频器件研发和产业化项目、马达驱动芯片研发和产业化项目、研发中心建设项目及发展与科技储备资金：五个项目截至期末累计投资金额都超过承诺投资金额，投入进度超过 100%，皆系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 2：高性能模拟芯片研发和产业化项目：调整后募集资金承诺投资总额不含首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见说明三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见说明三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不存在
募集资金结余的金额及形成原因	不存在
募集资金其他使用情况	详见说明三（七）

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 8 月 10 日										
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	生产建设	94,063.20	94,063.20	15,151.40	85,911.55	91.33	2026 年 3 月	不适用	不适用	否	2023 年 10 月 26 日	2023 年 11 月 14 日
研发中心建设项目	研发中心建设项目	生产建设	20,619.76	20,619.76	-	21,892.29	106.17	2023 年 10 月	不适用	不适用	否	2023 年 10 月 26 日	2023 年 11 月 14 日
发展与科技储备资金	发展与科技储备资金	研发项目	30,000.00	30,000.00	7,235.55	30,335.39	101.12	2026 年 6 月	不适用	不适用	否	2025 年 7 月 27 日	/

高性能模拟芯片研发和产业化项目	高性能模拟芯片研发和产业化项目	研发项目	66,783.59	66,783.59	13,967.40	38,666.72	57.90	2027年12月	不适用	不适用	否	2025年8月12日	/
合计			211,466.55	211,466.55	36,354.35	176,805.95							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金18,932.47万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。 公司分别于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，使用募集资金拟投入金额由40,824.76万元变更为21,892.29万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。										
			2025年7月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对55nm和40nmBCD先进工艺导入的投入。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-035）。										
			2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为2026年6月，该项目包括高性能电源管理芯片产品开发和信号链芯片产品开发，项目产品具有种类多、范围广、部分品类开发专业性门槛高等特点，随着细分市场竞争加剧，公司需要更多的时间分析最新市场需求，根据需求进一步升级迭代产品，以更好的适应市场变化，优化资源配置。同时，“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”的节余募集资金200,755,731.09元投入“高性能模拟芯片研发和产业化项目”后，可以支撑公司高性能模拟芯片的后续研发投入和升级迭代。在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至2027年12月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。										

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	2024 年 4 月 8 日，本公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》，因外部环境变化，公司无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延，董事会同意对“电子工程测试中心建设项目”将原计划达到预定可使用状态日期 2024 年 8 月延期至 2026 年 3 月。
	2025 年 7 月 27 日，本公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》，由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，拟将原用于“发展与科技储备资金”中的子项目拟投资金额进行调整，公司拟加大对 55nm 和 40nmBCD 先进工艺导入的投入，根据对未来投入规划的测算，将募投项目延期至 2026 年 8 月，以实现募投项目建设基础平台性及前瞻性的技术的目标。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目子项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-035）
	2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，“高性能模拟芯片研发和产业化项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月，在综合考量当前市场需求、募投项目进度、更有效利用募集资金和公司长期发展规划后，将“高性能模拟芯片研发和产业化项目”达到预定可使用状态日期相应延期至 2027 年 12 月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《艾为电子关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在项目可行性发生重大变化的情形